



Powered by creativity



TDK. The electronic components company.

2013年3月期 通期決算説明会

2013年4月26日
TDK株式会社

- ◆ 2013年3月期 連結業績概要
2014年3月期 連結業績見通しについて
代表取締役社長 上釜 健宏

- ◆ 2013年3月期 連結業績補足／第4四半期概要
執行役員/経理部長 桃塚 高和

- ◆ 受動部品事業について
専務執行役員 植村 博之

- ◆ 記録デバイス事業について
ヘッドビジネスグループゼネラルマネージャー
石黒 成直

2013年3月期 連結業績概要 2014年3月期 連結業績見通しについて

TDK株式会社
代表取締役社長
上釜 健宏

2013年3月期 連結業績概要



(億円)	2012年3月期 通期実績 (2011.4.1~2012.3.31)	2013年3月期 通期実績 (2012.4.1~2013.3.31)	対前年同期比	
			増減	増減率(%)
売上高	8,145	8,516	371	4.6
営業利益	187	216	30	15.8
営業利益率	2.3%	2.5%	0.2 pt	-
継続事業税引前利益	122	189	66	54.0
当期純利益	△ 25	12	36	-
1株当たり利益(円)	△19円6銭	9円50銭	-	-
為替	対ドルレート	79円7銭	83円3銭	5.0%の円安
	対ユーロレート	109円6銭	107円5銭	1.8%の円高
為替変動による 影響金額	売上高：約324億円の増収 営業利益：約41億円の増益			

◆連結売上高は前期比4.6%増、営業利益は前期比15.8%増

- 2期連続で期初業績予想を大幅下方修正
- 通信分野向け受動部品売上高の増加が想定を下回って推移
- ”産業機器及びその他”の売上高が前期比11.8%減少(*1)
 - 産業機器市場の低迷
 - 主に受動部品、磁石、電源の売上高が減少
- 金属磁石の主原料（レアアース）価格の大幅下落に伴う在庫評価損等
- HDD市場が期初想定を大幅に下回って推移

◆成長に向けた基盤構築のための構造改革実施

- 受動部品を中心とした構造改革を実施し計画どおり完遂

◆期末配当金見通しは30円（1月31日時点見通しと同額）

- 中間配当金40円（実績）と合わせ通期配当金見通しは70円

*1) 分野別売上高推移についての詳細は25～28ページに掲載しています

2014年3月期 連結業績予想及び配当金見通し



(億円)		2013年3月期 通期実績	2014年3月期 通期予想	対前年同期比	
				増減	増減率(%)
売上高		8,516	9,300	784	9.2
営業利益		216	300	84	38.9
営業利益率		2.5%	3.2%	0.7pt	-
継続事業税引前利益		189	280	91	48.1
当期純利益		12	130	118	983.3
1株当たり利益(円)		9円50銭	103円34銭	-	-
配当金(円)		上期：40円(実績) 下期：30円(見通し) 年間：70円(見通し)	上期：30円(見通し) 下期：40円(見通し) 年間：70円(見通し)	-	-
為替	対ドルレート	83円3銭	90円	-	-
	対ユーロレート	107円5銭	118円	-	-

- 目指す姿実現までのステップイメージ
- 成長に向けた事業基盤構築
- 成長シナリオ

事業環境変化に対応するための 踏み込んだ構造改革実施 (2012年3月期～2014年3月期)

- 事業ポートフォリオ適正化
- 生産拠点の最適化
- コスト構造の見直し
- 成長分野へのリソース重点配分

目指す姿実現

(2015年3月期～)

- ・非中核事業からの撤退
- ・国内外拠点の統廃合
(統廃合公表済み以外の拠点)

- ・受動部品の国内拠点統廃合
- ・有機EL事業売却
- ・遊休資産売却
- ・国内外の人員削減

- ◆13年3月期：受動部品を中心とした構造改革実施
- ◆14年3月期：事業ポートフォリオ適正化・構造改革は終盤戦

事業ポートフォリオ 見直し推進

- ・ブルーレイ事業からの撤退、売却、譲渡（～14年3月）
- ・他事業及び製品毎の見直し継続

生産拠点最適化

- ・国内外拠点の統廃合推進（統廃合公表済み以外の拠点が対象）
- ・直接及び間接コスト最適化など

効果金額見込み
80億円
(2015年3月期)

■構造改革費用として2014年3月期に100億円計上予定

徹底的なコスト構造の見直し

成長分野・中核事業に経営資源を集中

受動部品

成長戦略の中核と位置づけ**収益の柱**へと再生

- ・スマートフォンなど通信機器向け高周波部品は再び成長軌道へ
- ・インダクティブデバイスは通信・自動車分野を中心に成長継続
- ・セラミックコンデンサは構造改革を完遂し収益安定化、成長戦略へシフト

記録デバイス

(磁気応用製品)

HDD業界の変化を受けて

唯一のヘッド**専門メーカー**としての
ポジションを生かした**安定収益事業**へ

- ・データセンター向けヘッド開発強化
- ・熱アシストヘッド量産化加速
- ・ヘッド技術を応用した電子部品開発推進

二次電池

(フィルム応用製品)

垂直統合ビジネスモデルにより

次なる成長ステージへ

- ・材料～セル～パッケージングまで垂直統合(*1)
- ・磁気テープで培った技術を応用し機能性フィルム・セパレータ事業拡大(*2)
- ・電極材料の自社開発推進
- ・スマートフォン・タブレット端末以外の顧客・アプリケーション開拓

*1：2013年3月期 第2四半期においてNavitasys Technology Limited社買収（パッケージング）

*2：2011年11月 日東電工（上海）電電源に65%出資し、2013年3月31日現在78%保有（セパレータ）

2013年3月期 連結業績補足／第4四半期概要

執行役員／經理部長
桃塚 高和

2013年3月期 連結業績補足



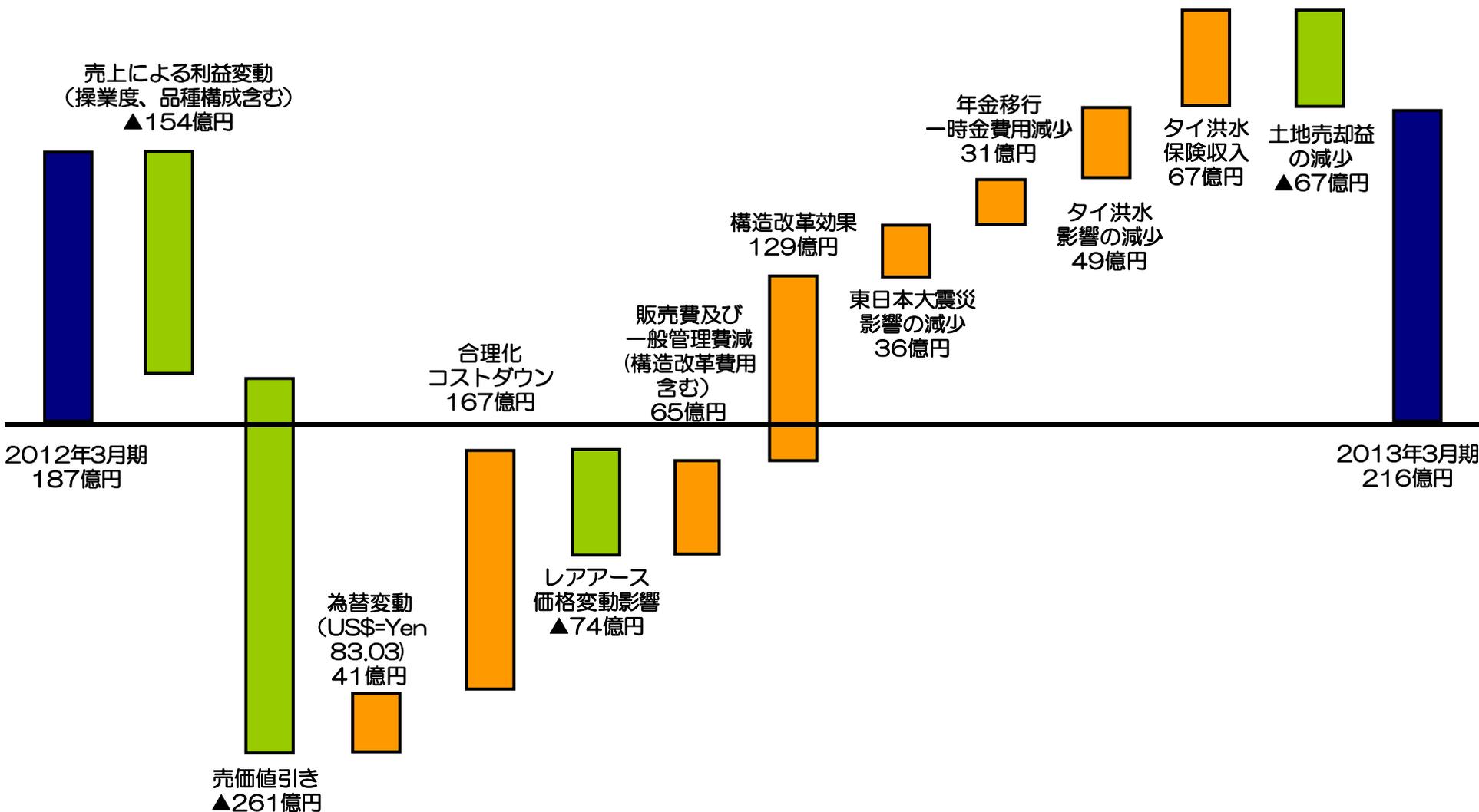
(億円)		2012年3月期 通期実績		2013年3月期 通期実績		対前年同期比	
		金額	%	金額	%	増減	増減率 (%)
売上高	コンデンサ	1,324	16.3	1,180	13.9	△144	△ 10.9
	インダクティブデバイス	1,212	14.9	1,196	14.0	△16	△ 1.3
	その他受動部品	1,280	15.7	1,421	16.7	140	11.0
	受動部品合計	3,816	46.9	3,796	44.6	△20	△ 0.5
	記録デバイス	2,087	25.6	2,335	27.4	248	11.9
	その他磁気応用製品	1,077	13.2	1,044	12.3	△33	△ 3.0
	磁気応用製品合計	3,164	38.8	3,379	39.7	215	6.8
	フィルム応用製品合計	927	11.4	1,126	13.2	199	21.5
	その他	238	2.9	214	2.5	△24	△ 10.1
	合計	8,145	100.0	8,516	100.0	371	4.6
営業利益	受動部品	△66	△ 1.7	△111	△ 2.9	△44	-
	磁気応用製品	390	12.3	371	11.0	△19	△ 5.0
	フィルム応用製品	63	6.7	124	11.0	62	98.5
	その他	△48	△ 20.3	△18	△ 8.3	31	-
	小計	338	4.2	367	4.3	28	8.4
	全社および消去	△151		△150		1	
	合計	187	2.3	216	2.5	30	15.8

営業利益増減分析

2012年3月期
187億円

営業利益 +30億円

2013年3月期
216億円



(億円)	2012年3月末	2013年3月末	増減
総資産	10,728	11,696	968
負債合計	5,608	5,890	282
株主資本	4,982	5,612	630
(うち包括利益)	△ 2,308	△ 1,590	718
株主資本比率	46.4%	48.0%	1.6pt
現預金・短期投資残高	1,734	2,235	501
有利子負債	2,728	2,956	228
ネットキャッシュ	△ 994	△ 721	273

セグメント情報 四半期比較



(億円)		2012年3月期 第4四半期 (2012.1.1~2012.3.31) (A)	2013年3月期 第3四半期 (2012.10.1~2012.12.31) (B)	2013年3月期 第4四半期 (2013.1.1~2013.3.31) (C)	対前年同期比増減 (C) - (A)		対直前四半期増減 (C) - (B)	
		増減	増減率(%)	増減	増減率(%)			
売上高	コンデンサ	316	266	307	△ 9	-2.8	41	15.4
	インダクティブデバイス	284	306	312	28	9.9	6	2.0
	その他受動部品	305	360	425	120	39.3	65	18.1
	受動部品合計	905	931	1,044	139	15.4	113	12.1
	記録デバイス	582	602	576	△ 6	-1.0	△ 26	-4.3
	その他磁気応用製品	297	240	245	△ 52	-17.5	5	2.1
	磁気応用製品合計	878	842	821	△ 57	-6.5	△ 21	-2.5
	フィルム応用製品合計	242	330	286	44	18.2	△ 44	-13.3
	その他	46	50	54	8	17.4	4	8.0
合計	2,070	2,154	2,205	135	6.5	51	2.4	
営業利益	受動部品	△ 132	△ 18	△ 39	93	-	△ 21	-
	磁気応用製品	140	75	18	△ 122	-87.1	△ 57	-76.0
	フィルム応用製品	△ 5	36	17	22	-	△ 19	-52.8
	その他	△ 26	△ 6	△ 3	23	-	3	-
	小計	△ 23	88	△ 8	15	-	△ 96	-
	全社および消去	△ 9	△ 37	△ 30	△ 21	-	7	-
	合計	△ 32	51	△ 38	△ 6	-	△ 89	-
営業利益率	-1.5%	2.4%	-1.7%	-0.2pt	-	-4.1pt	-	
為替	対ドルレート	79円27銭	81円17銭	92円20銭				
	対ユーロレート	103円94銭	105円28銭	121円74銭				

セグメント 区分	2013年3月期 通期実績	2014年3月期 通期予想 (対前年比)	主な要因・予想の前提
受動部品	3,796	+15~+20%	情報通信機器市場向け高周波部品、インダクティブデバイス、回路保護部品の増加 アルミ・フィルムコンデンサは産業機器向けに緩やかに回復 自動車市場向けは安定的に増加傾向
磁気応用製品	3,379	-2~0%	主にHDD市場の成熟化の影響
フィルム 応用製品	1,126	+15~+20%	情報通信機器市場向け二次電池及び機能性フィルム（ITOフィルム）の販売増加
その他	214	-	
合計	8,516	9,300	

為替レート \$/Yen 83.03
 為替レート EURO/Yen 107.05

為替前提

90.00
 118.00

受動部品事業について

専務執行役員
植村 博之

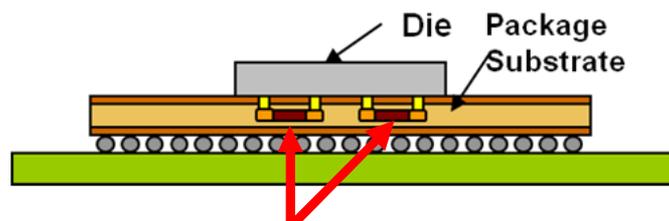
セラミック コンデンサ

- 国内外の製造拠点集約は13年3月期に完遂
- 構造改革効果で収益安定化
- 14年3月期は成長戦略へリソースシフト
- 自動車市場は引き続き最重要市場（高信頼性対応）
- 自動車用途などで養った要素技術の横展開による用途特化型製品の開発
- 高密度実装に対応した新製品開発
- コイルとのコラボ技術による超小型電源モジュールへの対応

用途特化型製品の例

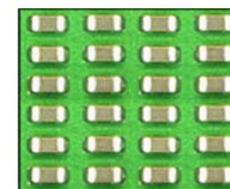


実装基盤のたわみに対応した
“メガキャップ”

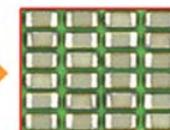


基板埋込技術に最適化した
超低背MLCC
(搭載イメージ)

高密度実装対応製品の例



実装スペース：12.4mm²



実装スペース：6.2mm²

特殊加工により高密度実装を
実現したSRCTシリーズ

高周波部品

- SAWデバイス及びモジュールビジネス拡大による売上増加及び収益改善
- SAWフィルタ（デュプレクサ含む）は増産対応中
 - ・ 足元の受注増加による増産対応
 - ・ 中期的な需要増加（単品外販及びモジュール用）に対する対応
- 次世代送受信技術（キャリアアグリゲーションなど）向けデザイン・イン活動加速
- 薄膜フィルタの市場投入
- 顧客ポートフォリオ適正化
- TDKグループ内シナジーの最大化追求
 - ・ 開発リソースの最適配置/製造ライン最適化促進

SAWデュプレクサ内蔵モジュール(FEMiD)の例

内蔵部品

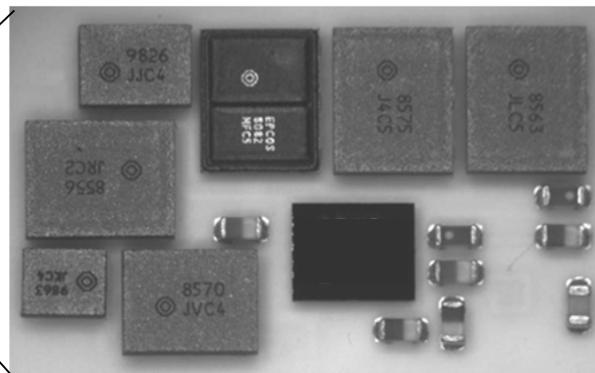
SAWデュプレクサx4

SAW/BAWデュプレクサx1

SAWフィルタx2

スイッチx1

マッチング用受動部品x8



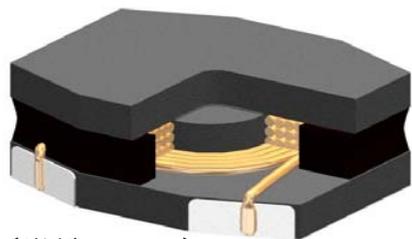
インダクティブ デバイス

- パワーコイルのラインナップ拡充
 - ・ 顧客ポートフォリオ分散による生産の平準化
 - ・ モバイル端末向けメタル系コイルの生産は大幅に増加
 - ・ 薄膜/巻線/積層工法で顧客要求に柔軟に対応
- 高周波コイルの開発・販売強化

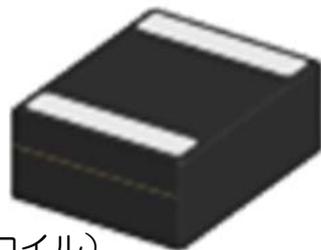
圧電材料部品

- スマートフォンカメラモジュール向けVCM(*1)・OIS(*2)の受注は引き続き好調、増産対応中

パワーコイル製品イメージ

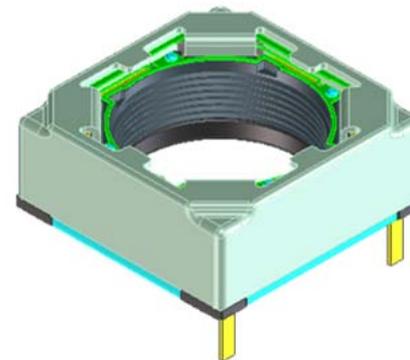


(巻線コイル)



(薄膜コイル)

VCM製品イメージ



*1 : Voice Coil Motor

*2 : Optical Image Stabilizer

記録デバイス事業について

ヘッドビジネスグループ
ゼネラルマネージャー
石黒 成直

●HDD市場

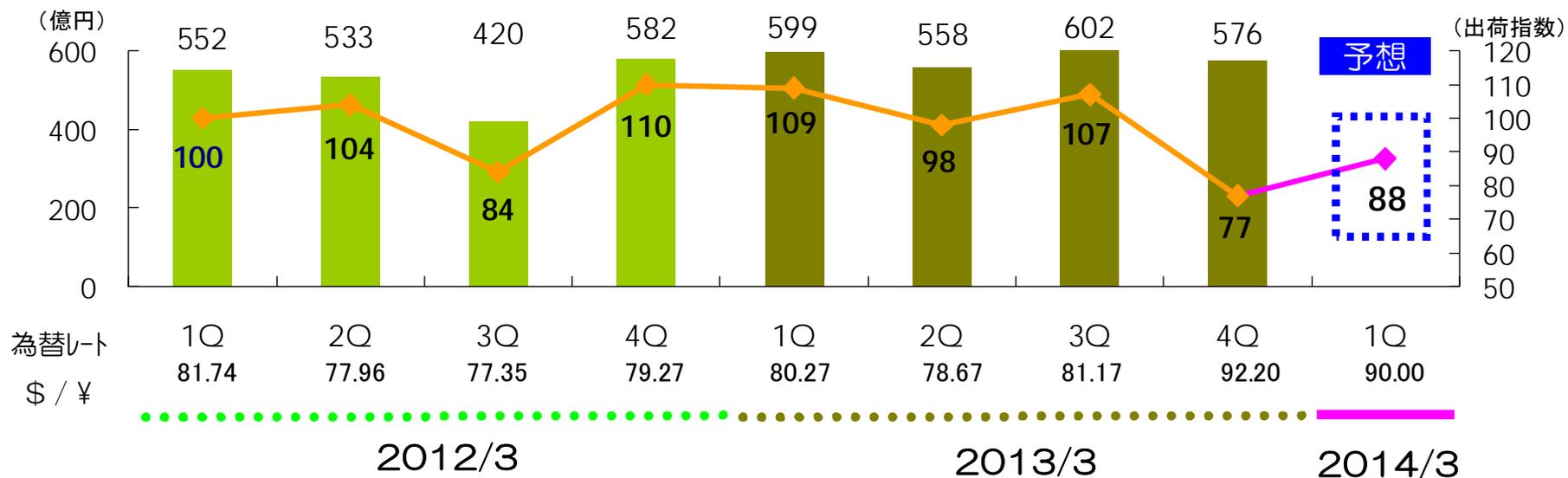
2013年3月期：約5.7億台(当社推定)

2014年3月期：約5.3億台(当社業績予想の前提)

●出荷指数

■ 記録デバイス売上高 (左軸、HDD用ヘッド及びHDD用サスペンションを含む)

◆ ヘッド (HGA) 数量出荷指数 (右軸、2012年3月期第1四半期の出荷数量を100とした場合の指数)



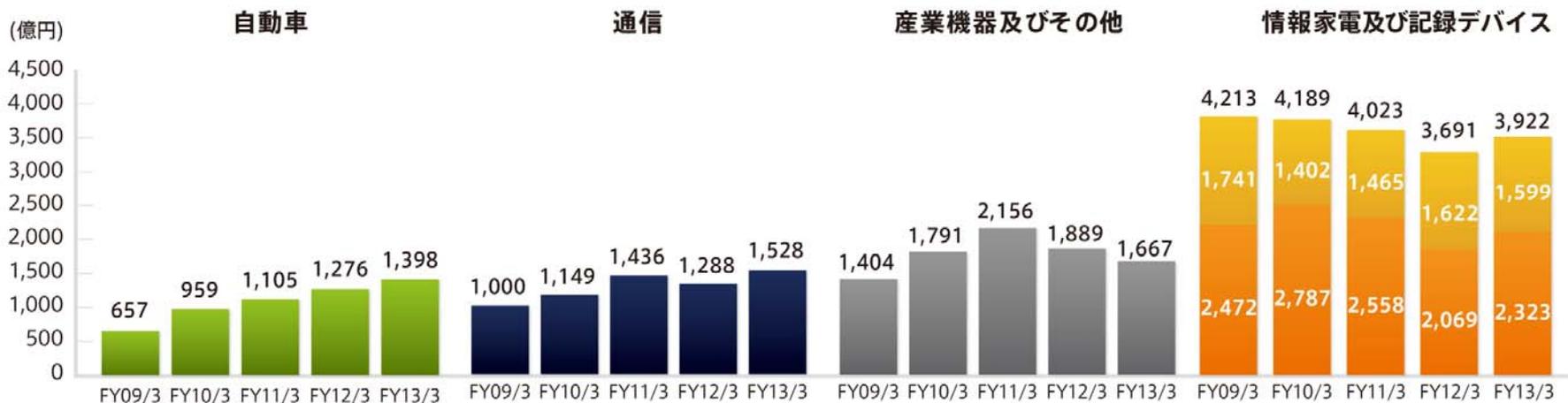
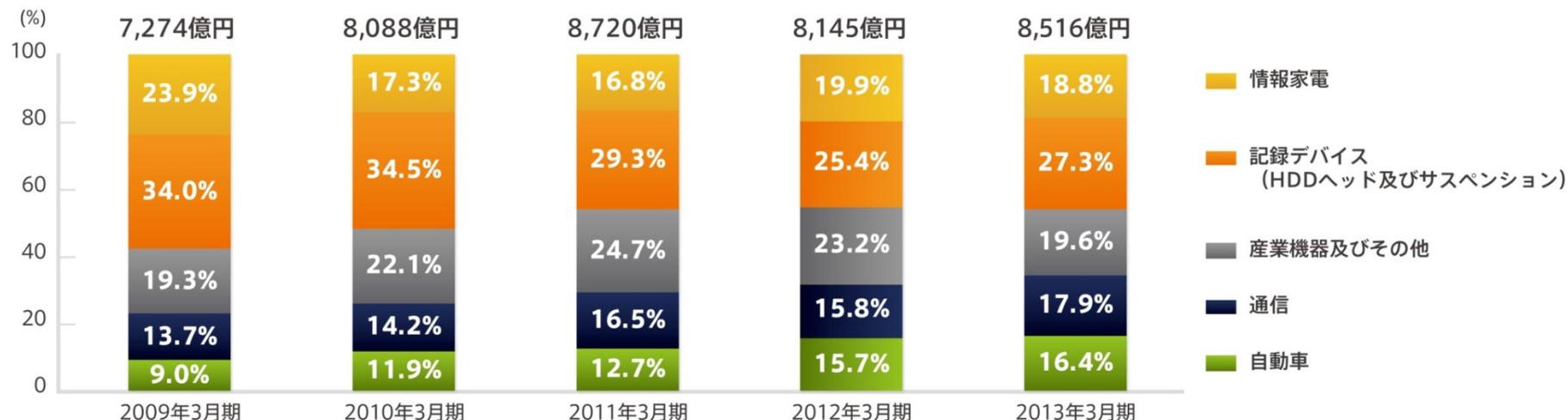
補足資料

売上高及び営業利益の四半期推移



		(億円)	2012年3月期					2013年3月期				
			1Q	2Q	3Q	4Q	通期	1Q	2Q	3Q	4Q	通期
売上高	コンデンサ	361	342	306	316	1,324	314	292	266	307	1,180	
	インダクティブデバイス	329	314	286	284	1,212	282	296	306	312	1,196	
	その他受動部品	328	344	304	305	1,280	318	317	360	425	1,421	
	受動部品合計	1,017	999	895	905	3,816	915	906	931	1,044	3,796	
	記録デバイス	552	533	420	582	2,087	599	558	602	576	2,335	
	その他磁気応用製品	244	277	260	297	1,077	283	276	240	245	1,044	
	磁気応用製品	796	810	680	878	3,164	882	834	842	821	3,379	
	フィルム応用製品	180	224	282	242	927	232	277	330	286	1,126	
	その他	67	66	57	46	238	58	52	50	54	214	
	合計	2,062	2,099	1,913	2,070	8,145	2,087	2,070	2,154	2,205	8,516	
営業利益	受動部品	38	13	15	△ 132	△ 66	△ 29	△ 25	△ 18	△ 39	△ 111	
	磁気応用製品	86	95	70	140	390	146	132	75	18	371	
	フィルム応用製品	12	26	29	△ 5	63	21	50	36	17	124	
	その他	△ 4	△ 12	△ 7	△ 26	△ 48	△ 4	△ 5	△ 6	△ 3	△ 18	
	小計	132	122	108	△ 23	338	134	152	88	△ 8	367	
	全社および消去	△ 72	△ 37	△ 34	△ 9	△ 151	△ 42	△ 41	△ 37	△ 30	△ 150	
	合計	60	85	74	△ 32	187	92	112	51	△ 38	216	
為替	対ドルレート	81.74	77.96	77.35	79.27	79.07	80.27	78.67	81.17	92.20	83.03	
	対ユーロレート	117.62	110.42	104.30	103.94	109.06	103.18	98.28	105.28	121.74	107.05	

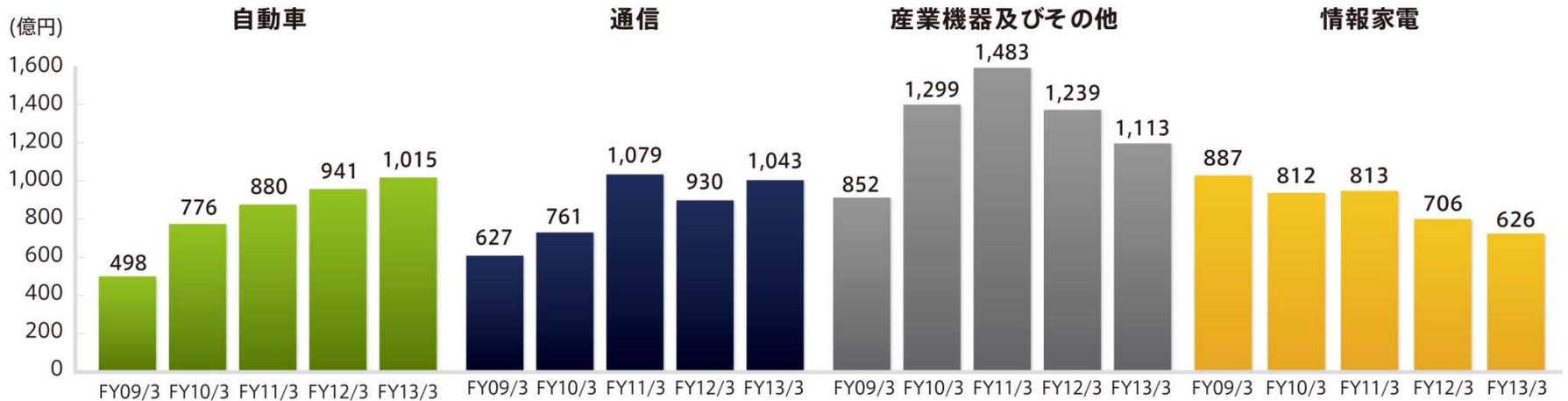
全社 分野別通期売上高推移 (2009年3月期～2013年3月期)



※ 2009年3月期の下期よりエプコス連結

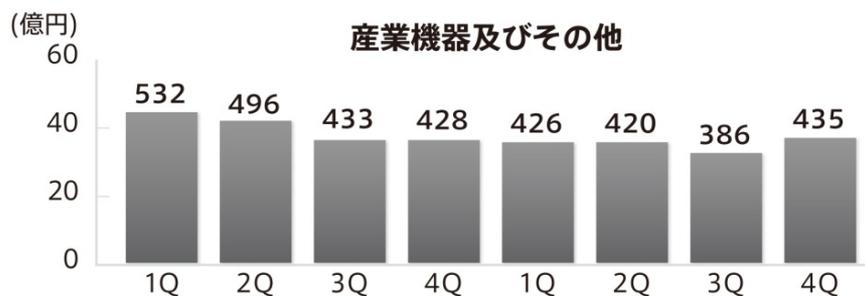
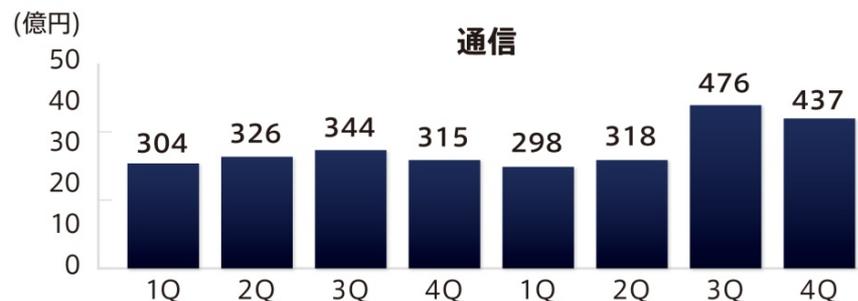
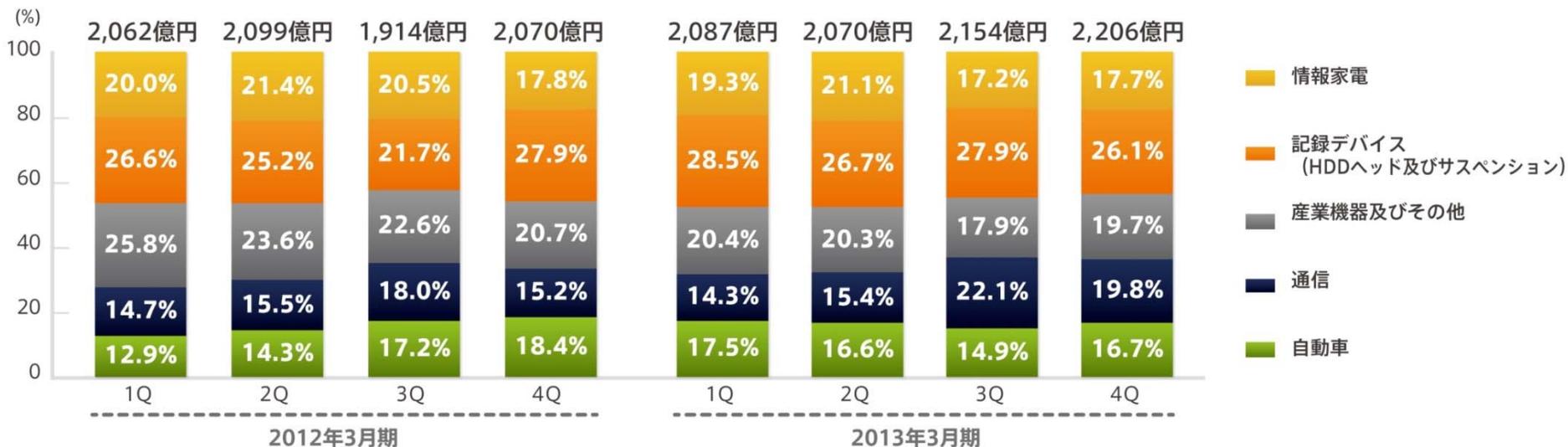
※ 2009/3～2010/3までは非継続事業(ディスプレイ事業)を含む実績、2011/3以降は非継続事業(ディスプレイ事業)除外後の実績値

受動部品 分野別通期売上高推移 (2009年3月期～2013年3月期)

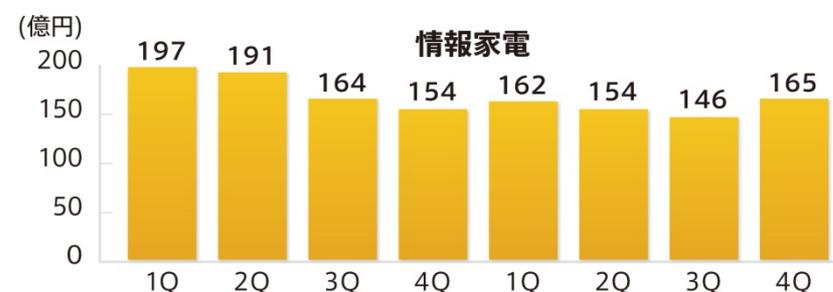
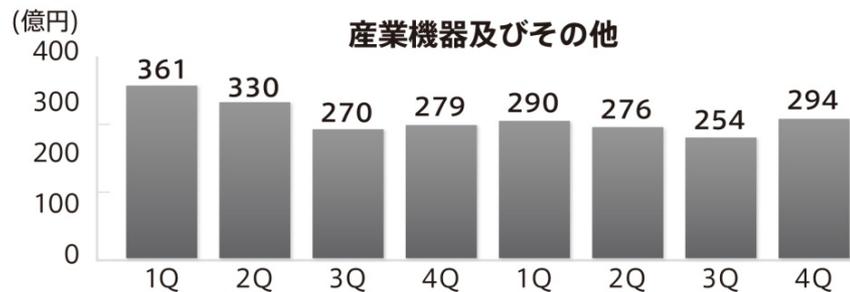
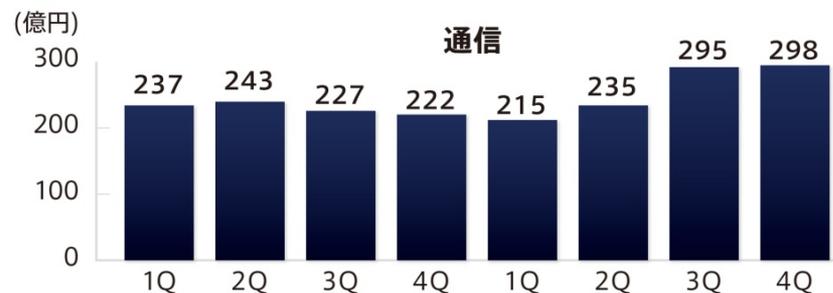
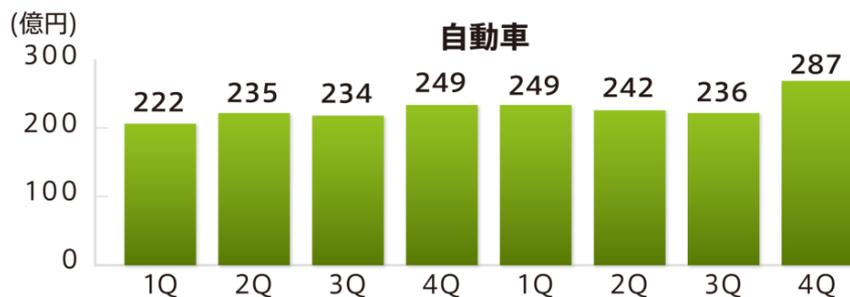
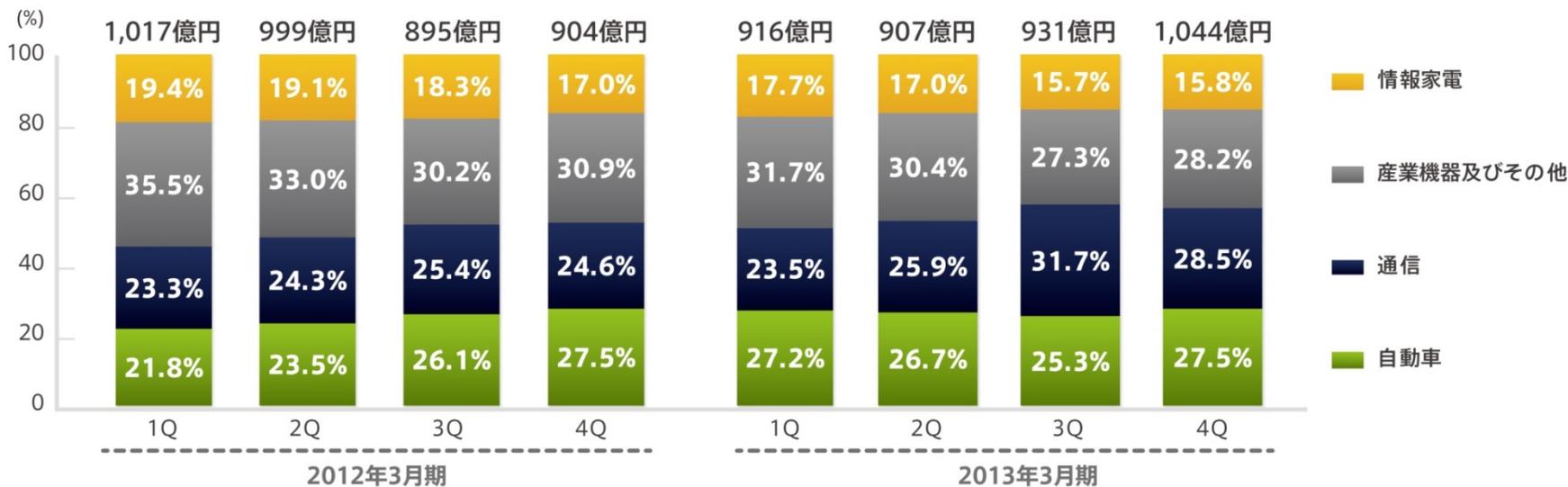


※ 2009年3月期の下期よりエプコス連結
 ※ 2009/3～2010/3までは非継続事業(ディスプレイ事業)を含む実績、2011/3以降は非継続事業(ディスプレイ事業)除外後の実績値

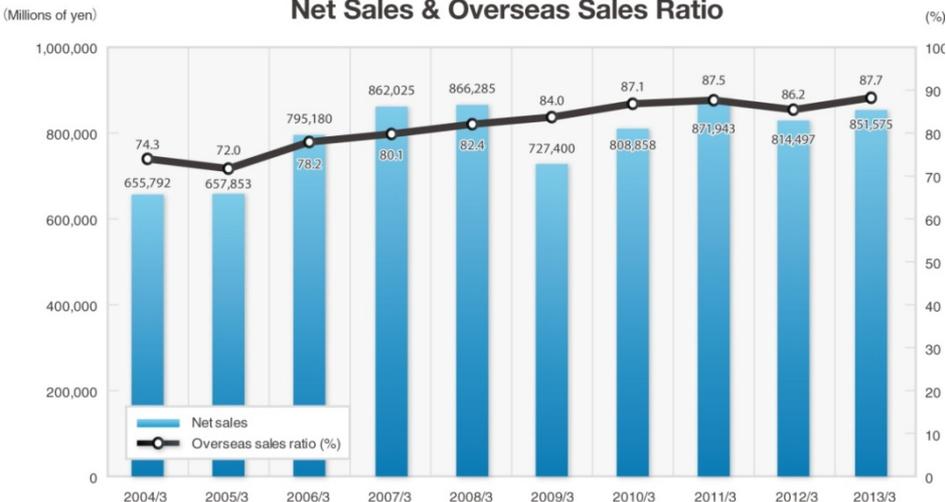
全社 分野別四半期売上高推移 (2012年3月期1Q~2013年3月期4Q)



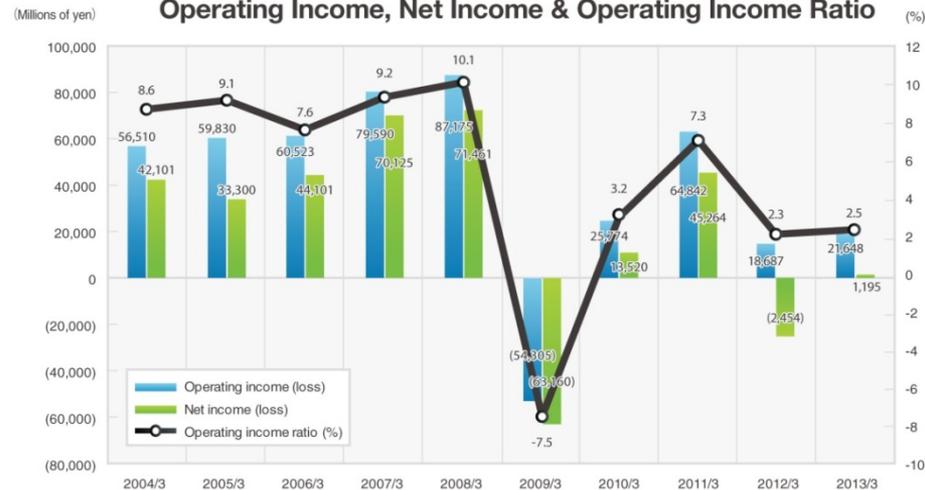
受動部品 分野別四半期売上高推移 (2012年3月期1Q~2013年3月期4Q)



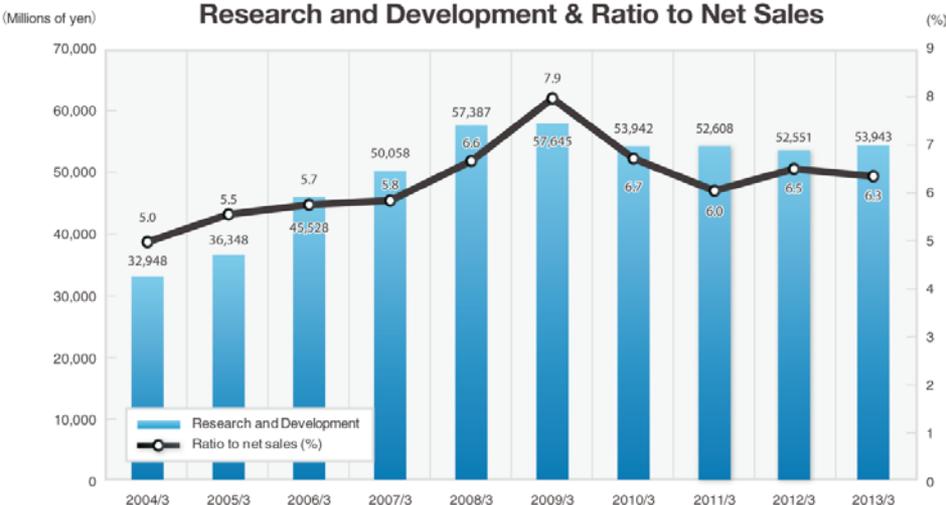
Net Sales & Overseas Sales Ratio



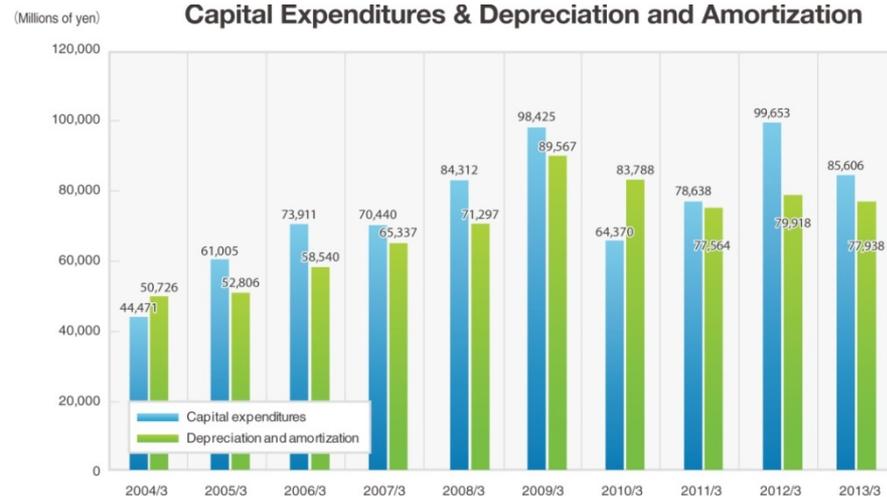
Operating Income, Net Income & Operating Income Ratio



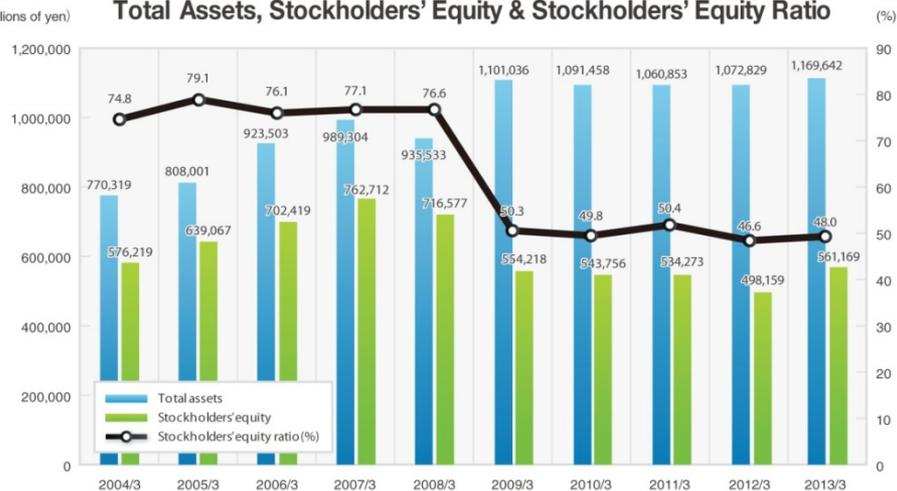
Research and Development & Ratio to Net Sales



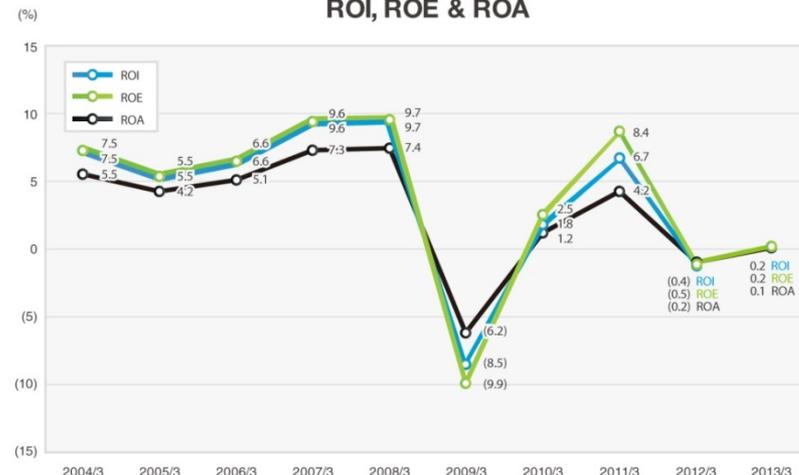
Capital Expenditures & Depreciation and Amortization



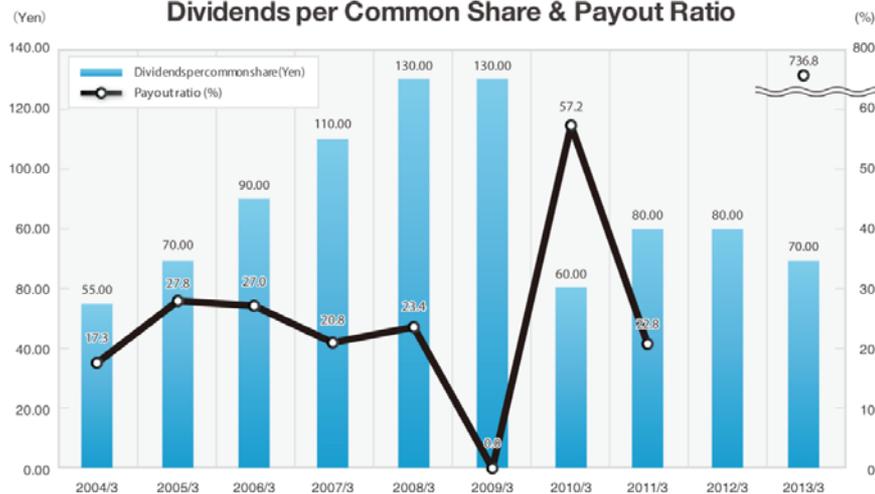
Total Assets, Stockholders' Equity & Stockholders' Equity Ratio



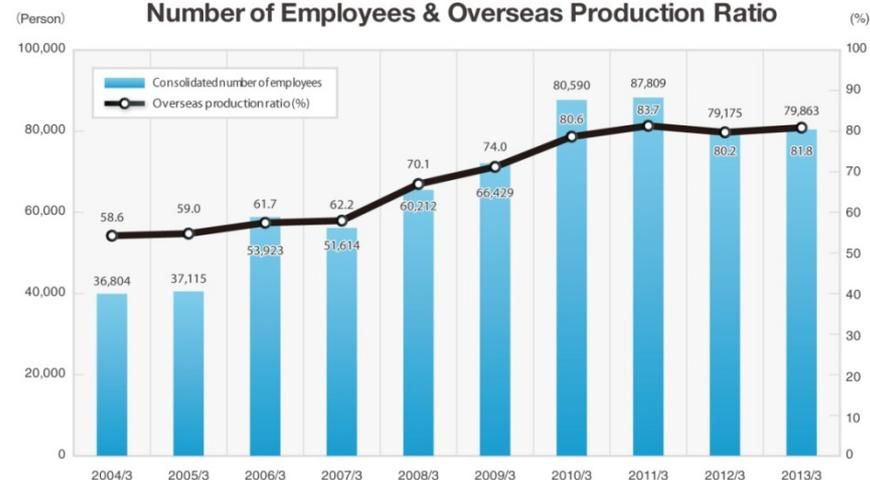
ROI, ROE & ROA



Dividends per Common Share & Payout Ratio



Number of Employees & Overseas Production Ratio



この資料には、当社または当社グループ（以下、TDKグループといいます。）に関する業績見通し、計画、方針、経営戦略、目標、予定、認識、評価等といった、将来に関する記述があります。これらの将来に関する記述は、TDKグループが、現在入手している情報に基づく予測、期待、想定、計画、認識、評価等を基礎として作成しているものであり、既知または未知のリスク、不確実性、その他の要因を含んでいるものです。従って、これらのリスク、不確実性、その他の要因による影響を受けることがあるため、TDKグループの将来の実績、経営成績、財務状態が、将来に関する記述に明示的または黙示的に示された内容と大幅に異なったものとなる恐れもあります。また、TDKグループはこの資料を発行した後は、適用法令の要件に服する場合を除き、将来に関する記述を更新または修正して公表する義務を負うものではありません。

TDKグループの主たる事業活動領域であるエレクトロニクス市場は常に急激な変化に晒されています。TDKグループに重大な影響を与え得る上記のリスク、不確実性、その他の要因の例として、技術の進化、需要、価格、金利、為替の変動、経済環境、競合条件の変化、法令の変更等があります。なお、かかるリスクや要因はこれらの事項に限られるものではありません。

又、本資料では、業績の概略を把握していただく目的で、多くの数値は億円単位にて表示しております。百万円単位にて管理している原数値を丸めて表示しているため、本資料に表示されている合計額、差額などが1億円の桁において、不正確と見える場合があります。詳細な数値が必要な場合は、決算短信及び補足資料を参照していただきますようお願いいたします。



決算説明会の質疑応答を含むテキスト情報は以下のページに後日掲載をいたします。
http://www.tdk.co.jp/ir/ir_events/conference/2013/4q_1.htm